

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 1 月 3 日 (03.01.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/000954 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C23F 1/18, H05K 3/38, 3/26
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/06061
- (22) 国際出願日: 2002 年 6 月 18 日 (18.06.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2001-190660 2001 年 6 月 25 日 (25.06.2001) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱瓦斯化学株式会社 (MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.) [JP/JP]; 〒100-8324 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 細見 彰良 (HOSOMI, Akiyoshi) [JP/JP]; 〒258-0112 神奈川県足柄上郡山北町950番地 三菱瓦斯化学株式会社 山北工場

- 内 Kanagawa (JP). 木暮 直毅 (KOGURE, Naoki) [JP/JP]; 〒258-0112 神奈川県足柄上郡山北町950番地 三菱瓦斯化学株式会社 山北工場内 Kanagawa (JP). 森山 賢一 (MORIYAMA, Kenichi) [JP/JP]; 〒258-0112 神奈川県足柄上郡山北町950番地 三菱瓦斯化学株式会社 山北工場内 Kanagawa (JP). 高橋 健一 (TAKAHASHI, Kenichi) [JP/JP]; 〒258-0112 神奈川県足柄上郡山北町950番地 三菱瓦斯化学株式会社 山北工場内 Kanagawa (JP). 細田 篤史 (HOSODA, Atsushi) [JP/JP]; 〒258-0112 神奈川県足柄上郡山北町950番地 三菱瓦斯化学株式会社 山北工場内 Kanagawa (JP). 池田 和彦 (IKEDA, Kazuhiko) [JP/JP]; 〒258-0112 神奈川県足柄上郡山北町950番地 三菱瓦斯化学株式会社 山北工場内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 永井 隆 (NAGAI, Takashi); 〒100-8324 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱瓦斯化学株式会社内 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: SURFACE TREATMENT AGENT FOR COPPER AND COPPER ALLOY

(54) 発明の名称: 銅および銅合金の表面処理剤

(57) Abstract: A surface treatment agent for copper and a copper alloy which comprises hydrogen peroxide, a mineral acid, an azole, a silver ion and a halogen ion. The surface treatment agent can be used for roughening the surface of a copper or copper alloy article, and allows the formation of a uniformly roughened surface of a copper clad substrate having a plated mirror surface, which has been conventionally difficult. As a result, the surface treatment agent can provide the markedly improved cohesion of such a copper clad substrate with a resin in the case of mounting an electronic component as well as in the case of using an etching resist, a solder resist or a prepreg, and thus is useful in the manufacture of a printed wiring board or the like in the electronic industry.

(57) 要約:

過酸化水素、鉍酸、アゾール類、銀イオンおよびハロゲンイオンを含有する銅および銅合金の表面処理剤である。電子工業分野におけるプリント配線板等の製造に有用な銅および銅合金の表面処理剤を提供する。この表面処理剤によれば、銅、銅合金の表面を粗化することが出来、従来困難であったメッキされた鏡面を含む銅張り基板に均一にムラの無い粗化表面を形成し、エッチングレジスト、ソルダーレジストに加え、プリプレグ、電子部品実装時における樹脂との密着性を格段に向上させることができる。



WO 03/000954 A1



2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。